

# 久元電子2017年第三季及公司現況與展望

發言人：劉復煌

2017年12月12日

# 今日議程

<u>議程</u>	<u>主講人</u>	<u>時間</u>
□ 歡迎法人蒞臨久元電子	陳總經理	14:00~14:10
□ 久元電子簡介及業績說明	劉復煌	14:10~14:30
□ 公司近況及未來展望說明	陳總經理	14:30~14:50
□ Q&A時間	陳總/劉復煌	14:50~15:30
□ 工廠參觀(採自由參加)	劉復煌	15:30~16:00



# 公司簡介

# 關於久元

1991年  
成立  
(共26年)

資本額  
12.85億  
(新台幣)

董事長  
汪秉龍

執行長  
葉瑞斌

員工  
1,094人

營業項目：

- **半導體及LED(光電)產品代工服務**：半導體封測、晶圓測試、研磨、切割、挑檢；LED產品測試、研磨、切割、挑檢與基板切割...等。
- **自有產品之研發、製造與銷售**：CCM影像感測模組測試設備、AOI自動光學檢測系統及全功IC 測試機(含邏輯、類比、混頻)、IC測試分類機、QFN測試包裝機、LED光電測試機、LED針測機、LED晶粒挑檢機、LED點膠機、LED測試分類機、LED包裝機...等。



# 久元大事紀

1991年07月公司設立，實收資本額新台幣伍佰萬元正。(久元一廠)

1998年10月研發出5MHz/40 Pins之Logic測試機(Goblin)。

2000年03月通過ISO-9001品質系統認證。

2000年07月全功能IC測試機通過工業局「主導性新產品開發計劃」審核。

2002年11月於櫃買中心興櫃股票掛牌交易。

2003年11月正式進入LED(光電)挑檢及測試代工服務。

2004年03月通過竹科核准成立新竹科學園區分公司(科技廠)。

2004年03月29日於櫃買中心上櫃股票掛牌交易(股票代碼:6261)。

2006年03月與美商安捷倫科技(Agilent)公司簽訂IC測試系統技術合作。

2006年12月通過ISO-14001及OHSAS-18001環安衛管理系統認證。

2007年07月成立台南安平廠營運LED挑檢及測試服務。

2008年05月通過竹科核准成立園區力行廠營運LED研磨、切割、挑檢、測試服務。

2008年10月通過ISO/TS16949品質系統認證。

2009年05月投資大陸成立廈門久元電子有限公司服務LED後段一貫化運作。

2009年06月太陽能矽基板暗裂瑕疵檢測設備、獲科管局專案補助。

2010年03月半導體研磨、切割、挑檢服務遷廠至新竹科學園區分公司(科技廠)。

2010年09月投資大陸江蘇成立常州久元光電有限公司服務LED後段一貫化運作。

2011年01月通過IECQ QC080000品質系統認證。

2011年12月投資大陸江蘇吳江巨豐電子服務半導體後段封測一貫化運作。

2012年02月投資大陸朗富科技(深圳)有限公司服務半導體後段測試。

2012年05月與日商Yoshikawa Semiconductor Co.,簽定合作備忘錄、擴展相關市場業務。

2013年12月榮獲經濟部工業局所主辦的第14屆「2013年度工業精銳獎」。

2015年05月創新式矽穿孔關鍵尺寸量測技術與系統開發獲科管局專案補助。

2015年06月創新廠營運IC成品測試服務。

2015年08月榮獲天下雜誌「天下CSR企業公民獎」。



# 營運據點



巨豐電子

- IC 後段封測一貫化服務

常州久元光電

- LED 後段測試及晶粒挑檢服務

一廠 (新竹)

- 特殊及基板切割服務

科技廠 (竹科)

- IC 後段一貫化服務、自有產品研發(ATE&AOI)

創新廠 (竹科)

- IC 成品測試服務

力行廠 (竹科)

- LED 後段一貫化服務、自有產品研發(LEW)

安平廠 (台南)

- LED 後段測試及晶粒挑檢服務

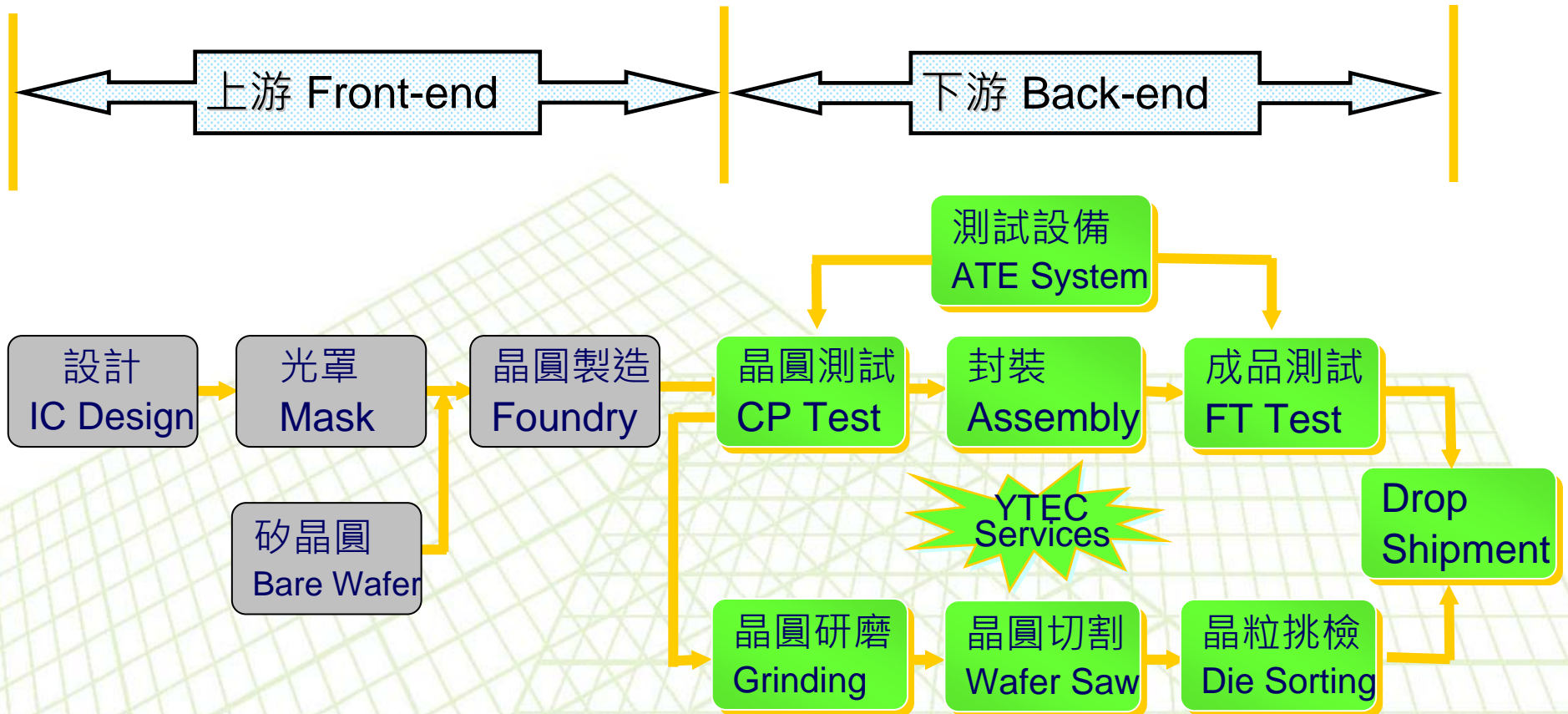
廈門久元電子

- LED 後段測試及晶粒挑檢服務



# IC測試 Turnkey Solution

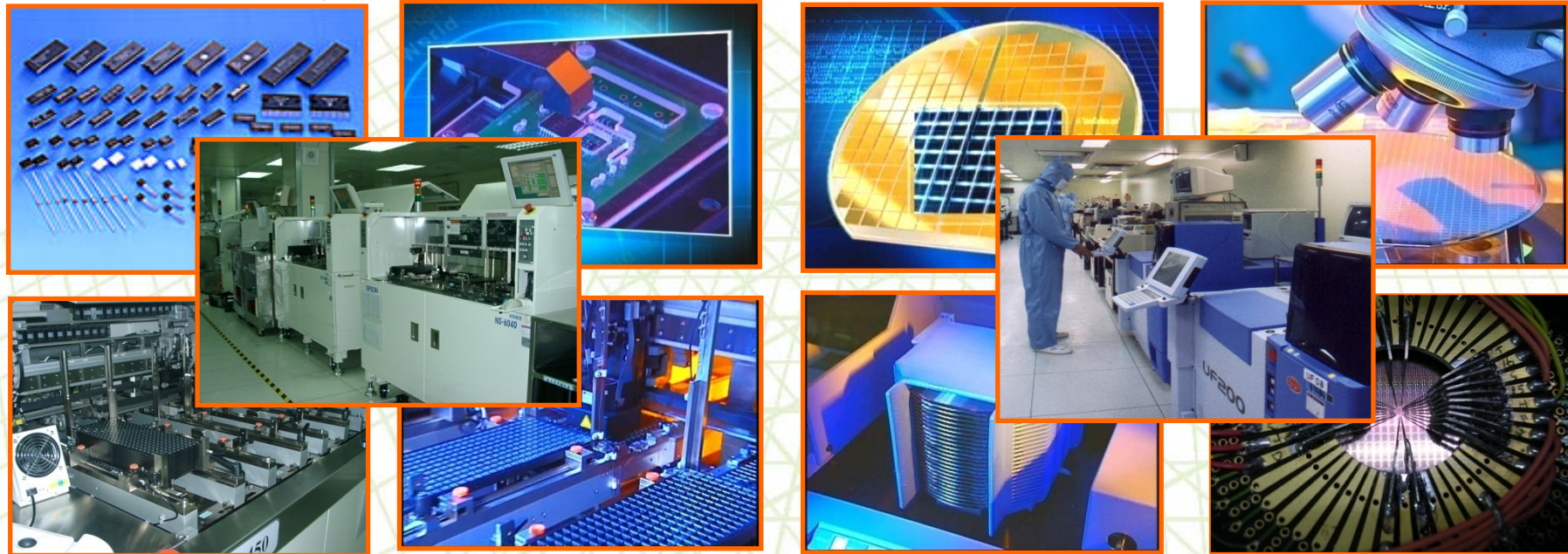
# 半導體產品代工服務





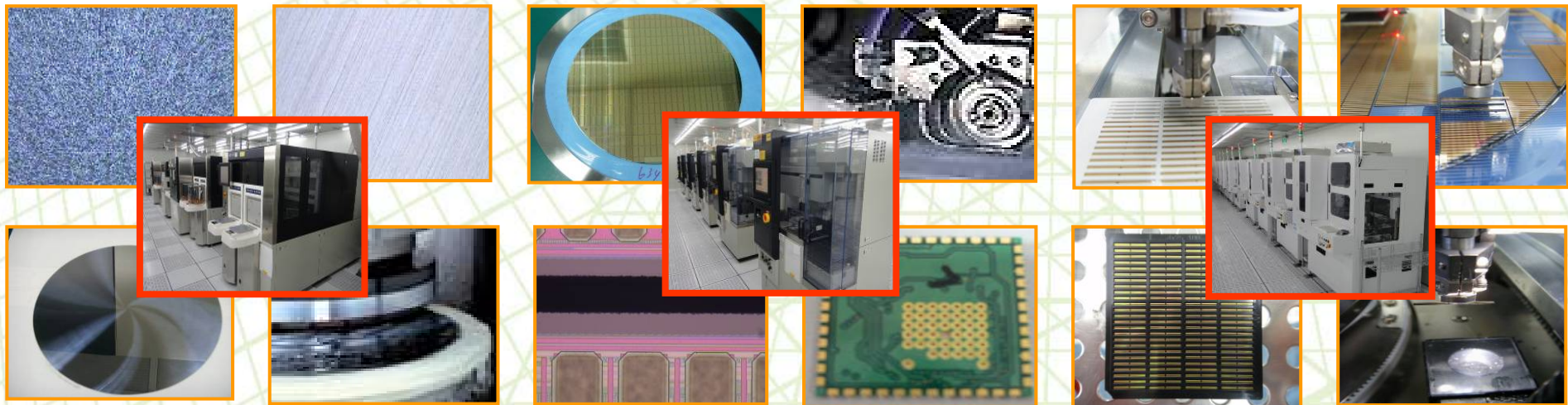
# 專業測試代工服務

- 4"~12"晶圓測試(CP)、測試程式及週邊治具開發(Probe-card自行製作能力)。
- IC成品電性測試(FT)、測試包裝形態：DIPs、T/SOPs、L/QFPs、QFN、L/BGA..等。
- PC週邊產品、邏輯(Logic)、類比(Analog)、混合訊號(Mixed-signal)、非揮發性(Non-volatile)記憶體、MCU、LCD驅動IC、高速/高腳數產品(Scud-1A 512C)、CIS(CMOS Image Sensor)、RF、MEMS、SOC產品等測試。
- 其他服務：L/S腳檢驗、測試程式及治具開發等工程技術支援、一貫化(Turn-key)服務、如封裝(Assembly)、Tape-reel、Drop-shipment等。



# 研磨、切割及挑檢代工服務

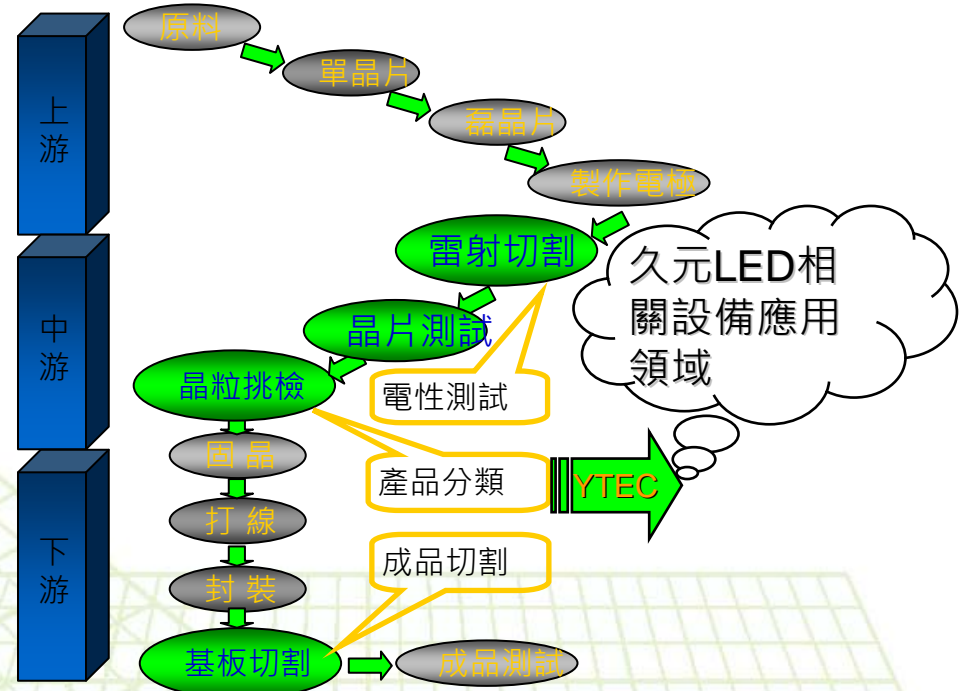
- ❑ IC Grinding、Sawing、Pick & Place
  - 4"~12" Wafer back-side grinding、sawing、chip pick & place services for Consumer and gold bump COG products。
  - Pick & Place Chip Back-side AOI inspection System inside。
- ❑ Substrate Sawing
  - LED package substrate、Glass substrate、Ceramic Substrate、Ceramic+FR4、Lead-frame、QFN package、HTCC、LTCC、PCB。





# LED Turnkey Solution

# 光電產品代工服務

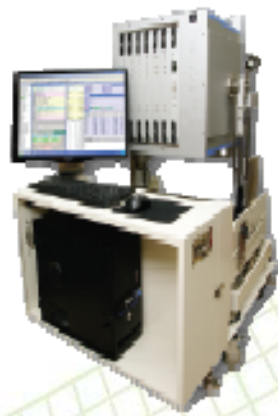


- ⇒ 上游磊晶成品：單晶片、磊晶片，如砷化鎵 (GaAs)、磷砷化鎵 (GaAsP)、砷化鋁鎵 (AlGaAs)、磷化鋁鎵銦 (AlGaInP) 等二元、三元、四元磊晶片
- ⇒ 中游晶粒成品：晶片測試、晶粒切割及挑檢等
- ⇒ 下游封裝成品：Lamp、Display、SMD、紅外線傳輸模組、光通訊產品



# 自有設備銷售

# IC 封裝及測試分類應用設備



**YTS100**

全功能高頻SoC IC  
測試機



**YT6100**

Fat Type  
IC測試分類機



**YT6200**

QFN測試包裝機

**Scud-1A**

全功能高速測試機



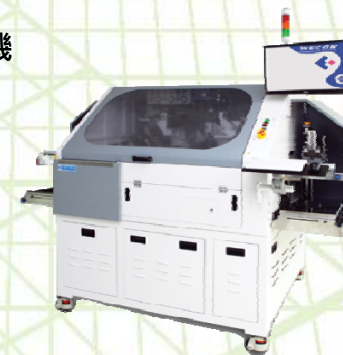
**IS-610**

全自動晶粒分類機

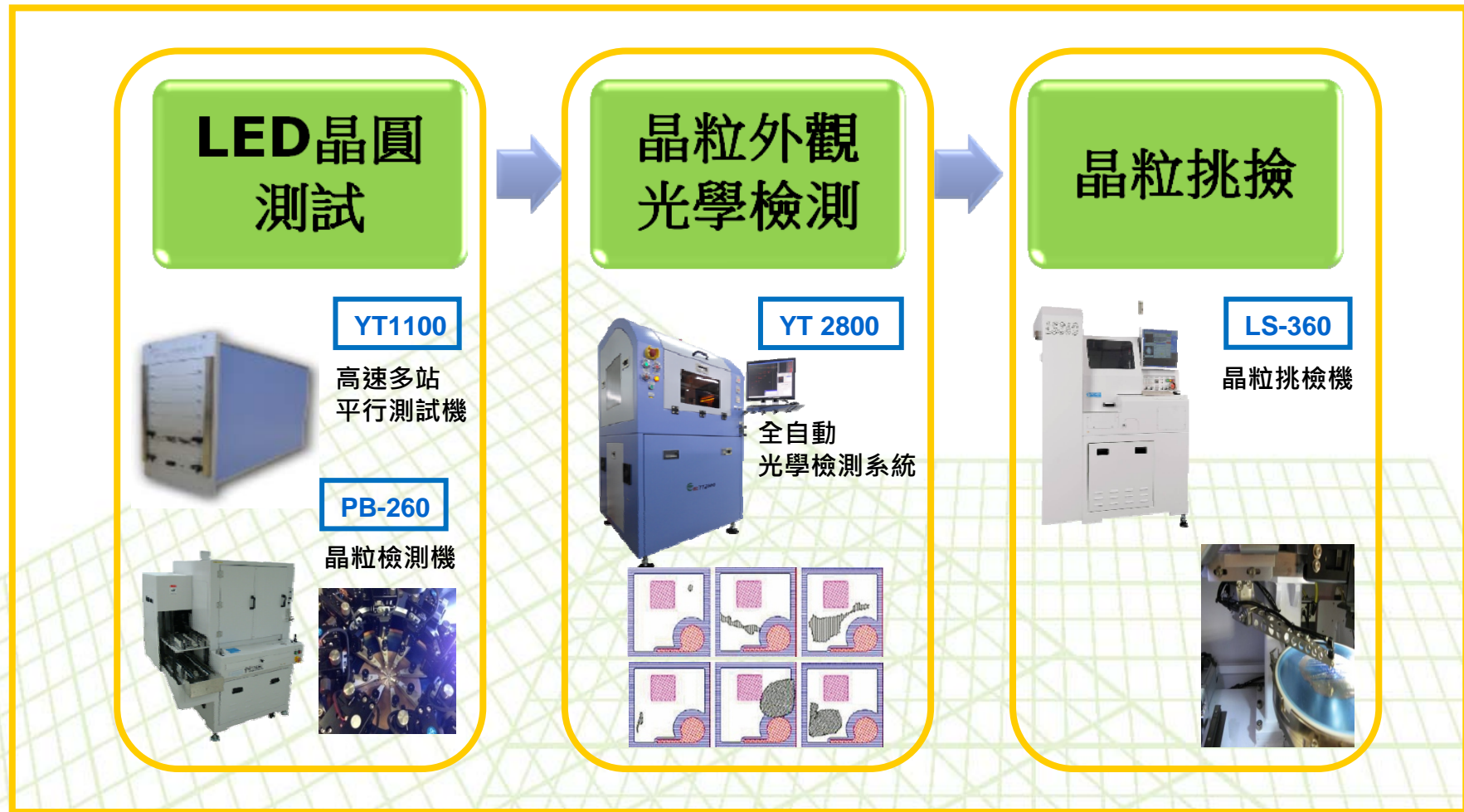


**SB-800**

全自動IC固晶機



# LED 晶粒測試分挑流程



# LED 封裝生產流程應用





# 自動光學檢測應用

被動元件、LED  
產品六面外觀檢測



**YT2300**

元件六面外觀  
檢測機

**YT2330**

被動元件六面外觀  
檢測機

LED及被動元件散熱基板  
產品之外觀檢測



**YT2700**

LED及被動元件  
散熱基板之2D AOI  
檢測機



**YT2705**

LED及被動元件  
散熱基板之2D AOI  
檢測機  
(Auto Load/Unload)



# 影像感測模組測試設備CCM (CMOS/Compact Camera Module)

影像感測模組測試設備  
CCM YT3100



全自動影像感測模組測試設備  
CCM YT3300



## 經營理念及願景

**經營理念**：主人翁經營理念；下工程即是客戶。

**工作態度**：成功者找方法；失敗者找藉口。

**願景**：著眼於國內外市場的開拓，讓久元成為立足台灣的整合性後段IC及LED一貫化服務廠，並朝放眼世界的自有產品、自有品牌邁進。

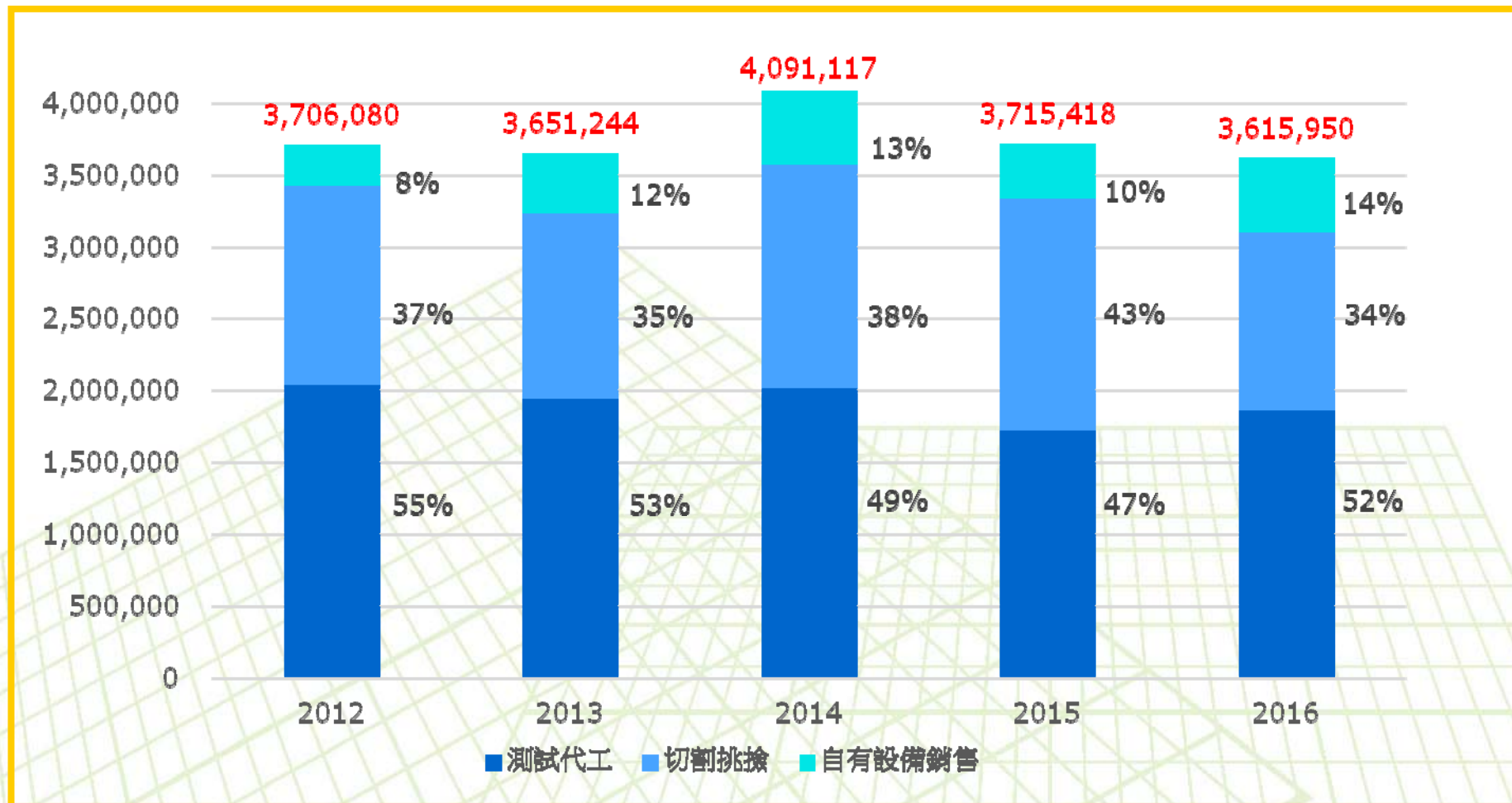




# 財務數據

# 近5年合併營收

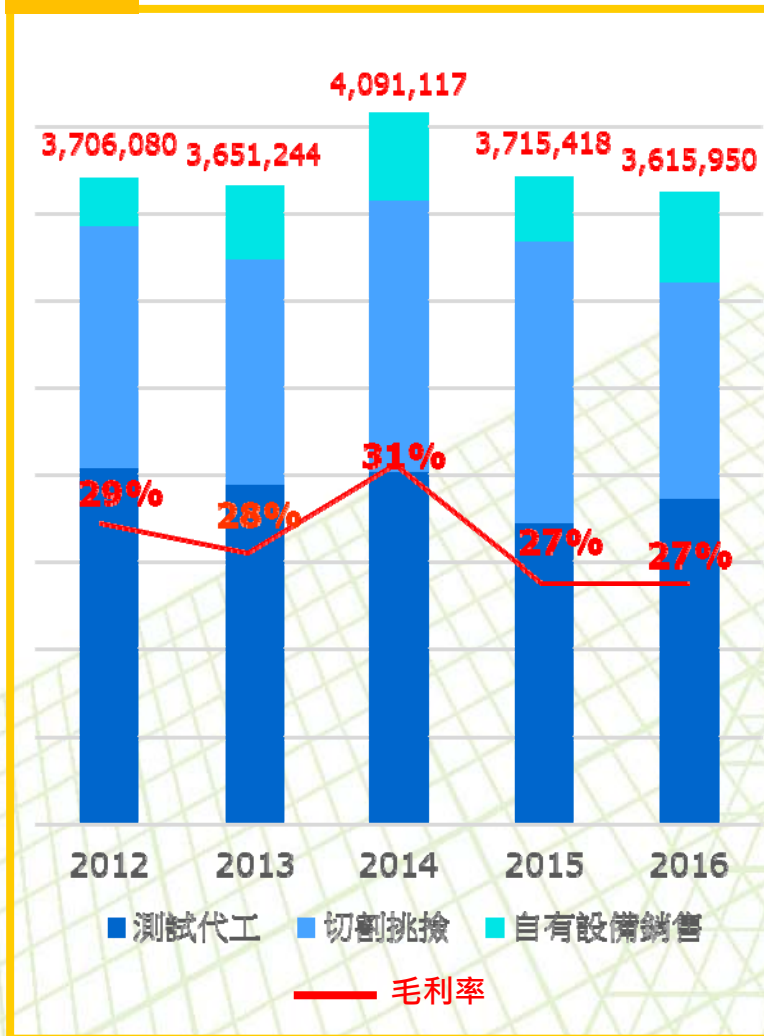
新台幣: 仟元



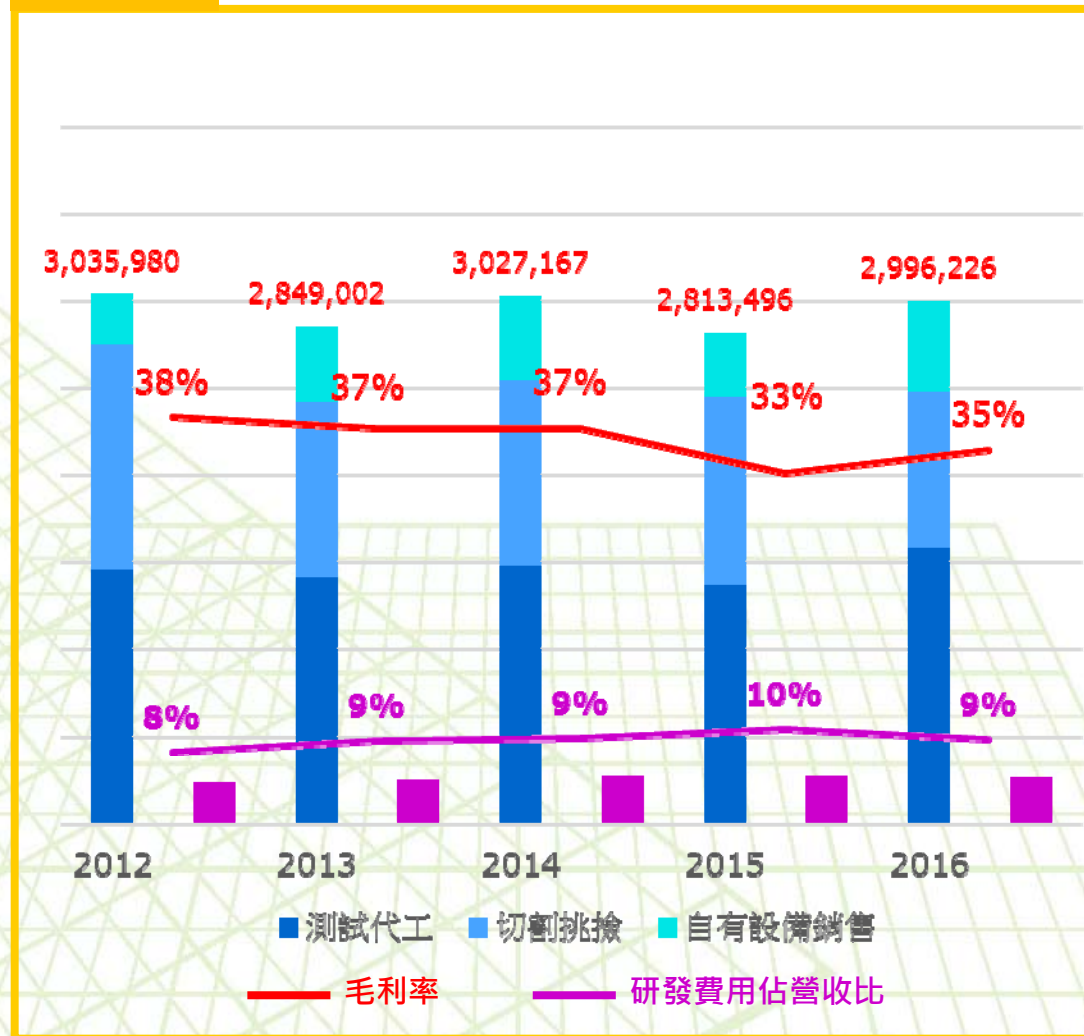
# 近5年財務表現

新台幣: 仟元

## 合併



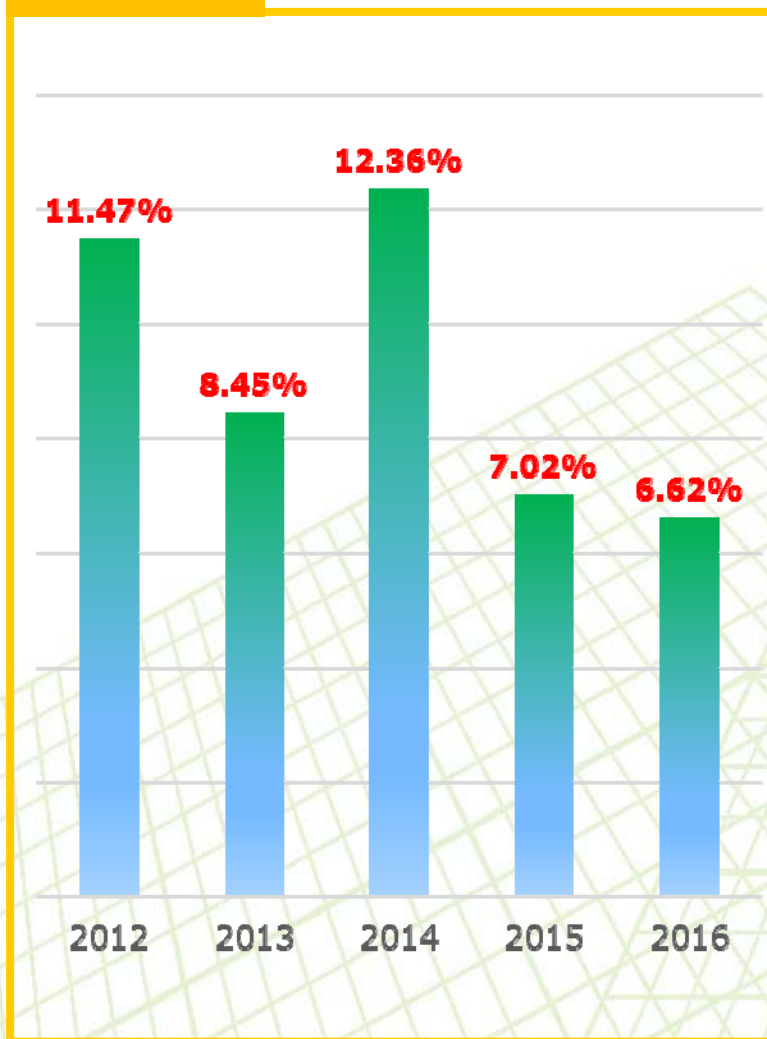
## 母公司



# 近5年股東報酬率及股利政策

每股盈餘: 元  
現金股利: 元

## 股東報酬率



## 股利政策





# 2017年Q3及11月財務數據



# 2017年前三季合併損益表摘要

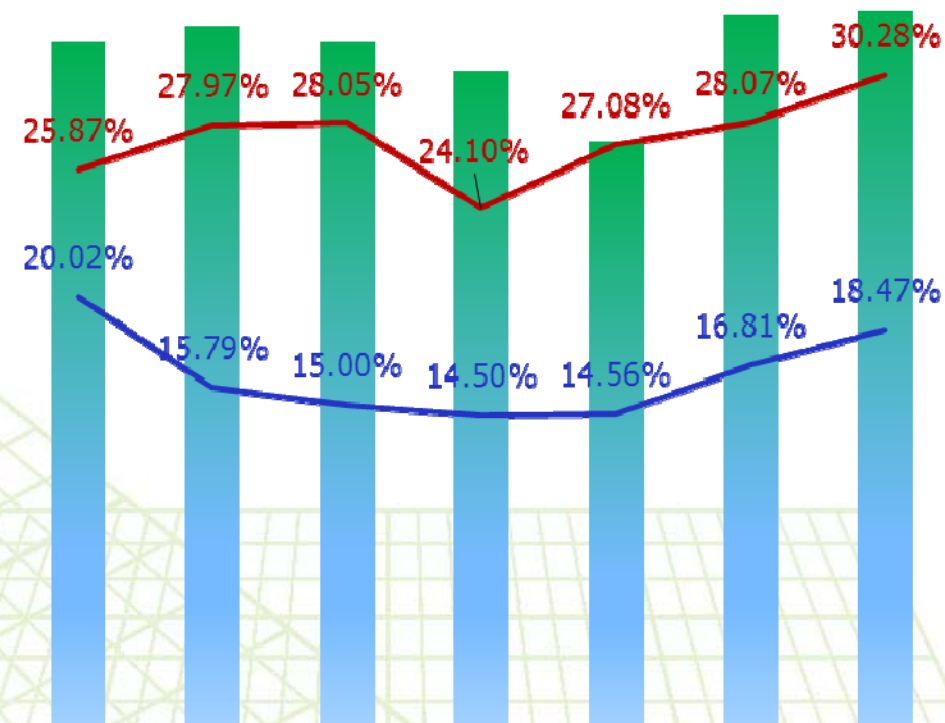
新台幣: 仟元  
每股盈餘為元

	2017年第三季		2016年第三季		2017年前三季		2016年前三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	950,499	100	910,410	100	2,672,113	100	2,744,580	100
營業成本	662,708	70	655,070	72	1,908,712	71	1,995,360	73
營業毛利	287,791	30	255,340	28	763,401	29	749,220	27
推銷費用	24,916	3	20,004	2	70,262	3	73,669	3
管理費用	39,221	4	40,132	4	125,139	5	111,738	4
研究發展費用	60,464	6	69,290	8	196,580	7	202,587	7
營業費用合計	124,601	13	129,426	14	391,981	15	387,994	14
其他收益及費損淨額	12,396	2	10,693	1	76,091	3	103,377	4
營業淨利	175,586	19	136,607	15	447,511	17	464,603	17
營業外收入及支出合計	22,504	2	(32,000)	(3)	(21,918)	(1)	(75,138)	(3)
稅前淨利	198,090	21	104,607	12	425,593	16	389,465	14
所得稅費用	39,507	4	25,969	3	88,679	3	80,992	3
本期淨利	158,583	17	78,638	9	336,914	13	308,473	11
其他綜合損益合計	81,784	8	(60,818)	(7)	39,723	1	(147,636)	(5)
本期綜合損益總額	240,367	25	17,820	2	376,637	14	160,837	6
淨利(損)歸屬於：								
本公司業主	168,798	18	91,569	10	364,530	14	352,217	13
非控制權益	(10,215)	(1)	(12,931)	(1)	(27,616)	(1)	(43,744)	(2)
	158,583	17	78,638	9	336,914	13	308,473	11
每股盈餘(基本)	\$ 1.31		\$ 0.71		\$ 2.84		\$ 2.74	
每股盈餘(稀釋)	\$ 1.30		\$ 0.71		\$ 2.81		\$ 2.71	

# 2016-2017年季營收同期比較

新台幣: 仟元

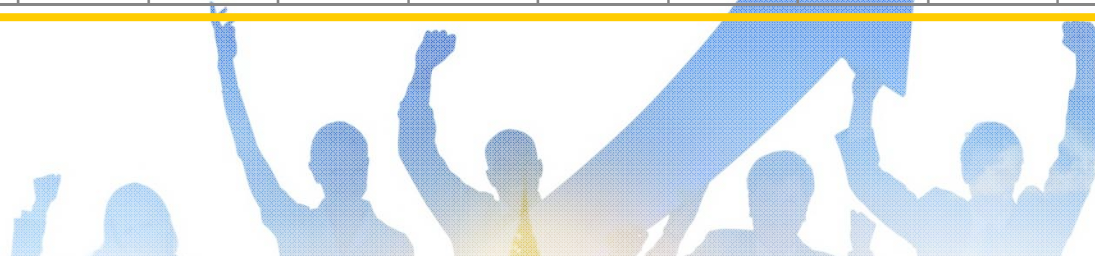
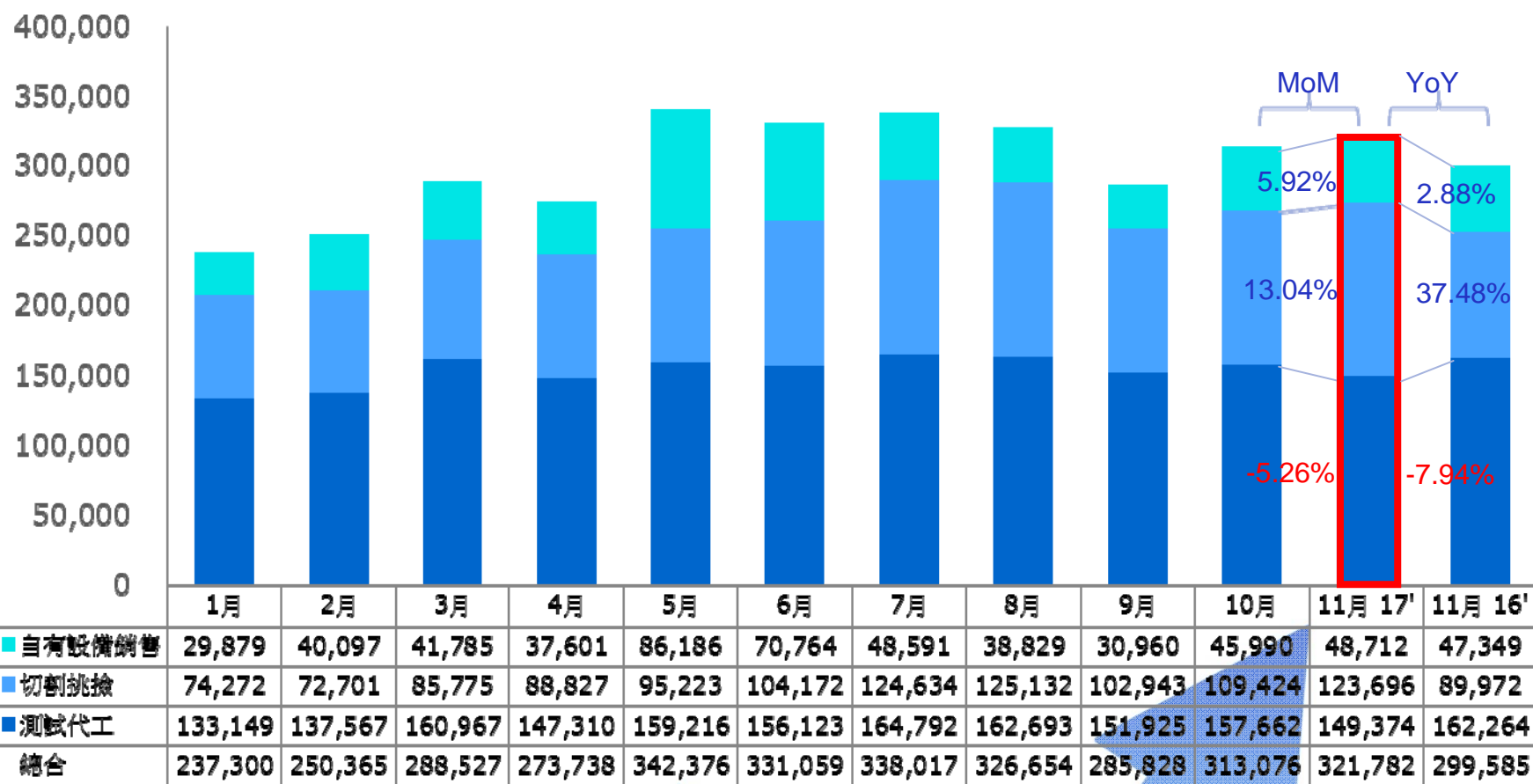
- ❖ 總營業收入: \$9.5億新台幣、季增加0.5%，年增加4.8%。
- ❖ 營業毛利率: 30.28%。
- ❖ 營業淨利率: 18.47%。
- ❖ 稅後淨利: \$1.69億新台幣、季增加8%、年增加84.3%。
- ❖ 2017年第3季摘要說明:  
本季三項主要產品線營收(切挑、測試OEM、機器組裝產品銷售)與去年同期分別成長10.5%、0.2%、7.7%。



	2016 Q1	2016 Q2	2016 Q3	2016 Q4	2017 Q1	2017 Q2	2017 Q3
營業收入	908,404	928,790	907,386	871,370	776,192	945,422	950,499
毛利率	25.87%	27.97%	28.05%	24.10%	27.08%	28.07%	30.28%
營業淨利率	20.02%	15.79%	15.00%	14.50%	14.56%	16.81%	18.47%

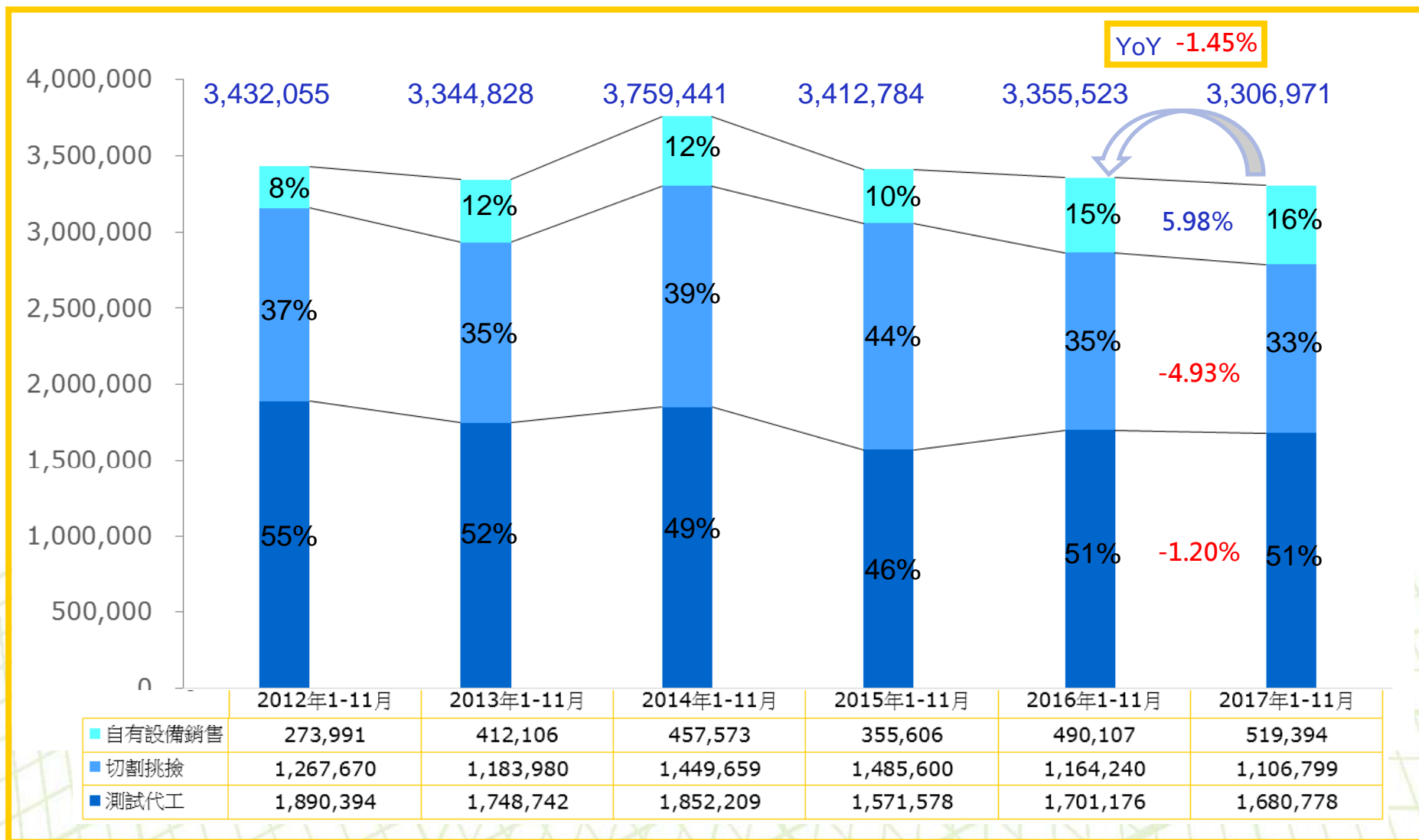
# 2017年1-11月營運概況

新台幣: 仟元



# 2012-2017年1-11月累計營收同期比較

新台幣: 仟元



# 2017年1-11月回顧及未來展望

- ❖ **半導體及光電切挑代工服務**：2017年Q3營收QOQ成長22.4%、YOY成長10.5%、11月YOY成37.5%、MOM成長13%,符合預期,因此將持續追蹤、另 LED在新的應用提昇下、公司亦開發新專案,應可適時提供市場成長之需求、相信可挹助公司之營收成長。
- ❖ **IC測試系統、IC固晶、挑揀設備及QFN測試包裝機、分類機開發**：成功的開發完成100MHZ 768/1536 pins全功能IC測試機、針對多媒體、Digital TV及高速邏輯SOC產品並行測試、並導入量產、更高階機種亦將陸續上市、另研發出IC封裝製程之固晶及挑揀設備與QFN測試包裝機及分類機、可應用於IC封裝製程及成品測試生產、更具備三合一功能(測試、外觀檢測及包裝)、以提昇IC測試代工服務之競爭優勢。
- ❖ **CIS、CCM、LED後段生產設備及AOI設備開發**：成功開發完成CIS(CMOS影像感測系統)、具備高速影像處理及完整電性測試之解決方案、並導入代工服務、挹助營收。  
自行開發之CCM(影像感測模組測試設備)、LED後段生產設備及AOI(自動光學檢測系統)等設備、因應市場需求將擴展銷售、AOI設備研發係以解決半導體及光電等產業在目檢之視覺盲點並可大幅節省人力、並已將光電技術結合影像分析與自動化設備設計、成功研發出各類型外觀檢測機。  
綜觀設備銷售2017年Q3營收YOY成長7.7%、11月份YOY成長2.9% MOM成長5.9%符合預期、因此將持續追蹤、相信在持續開發新產品及功能提昇下、展望未來應可持續挹助業績成長之動力。
- ❖ **半導體代工服務**：2017年Q3營收YOY成長0.2%、QOQ成長3.6%符合預期、11月份MOM降-5.3%,因此將持續追蹤、而YTEC 在持續開發新產品與互補及平衡的產品線發酵下(如LCD、RF、MEMS、Finger print...etc)、展望未來應可持續挹助業績成長之動力。



Q&A